

exceet auf der SMT Hybrid 2016: AEMtec informiert über Neuigkeiten zum Waferprocessing

- Deutlich schnellere Durchlaufzeiten bei der Vorbereitung der Wafer für die Flip Chip-Prozesse

Rotkreuz, Berlin, 19. April 2016 – Die AEMtec GmbH, ein Unternehmen der Technologiegruppe exceet und Spezialist für Mikro- und Optoelektronik höchster Qualität, stellt auf der diesjährigen SMT Hybrid neuste Fertigungsmöglichkeiten im Bereich der Reinraumproduktion vor.

AEMtec zählt zu den führenden Anbietern, wenn es um die Produktion von Modulen zur optischen Datenübertragung, Sensoren und Kameramodule in außergewöhnlicher Qualität, geht. Auf der SMT Hybrid vom 26.-28. April 2016 in Nürnberg, erhalten interessierte Besucher einen Überblick zu neuen Leistungsmöglichkeiten der AEMtec im Wafer Back-End Bereich. Dank neuer Produktionsanlagen kann der Technologiespezialist zusätzliche Fertigungsschritte entlang der Wafer Wertschöpfungskette übernehmen und den Kunden somit die stark verkürzten Durchlaufzeiten für kleine und mittlere Serien anbieten.

Modernste Technologien erfüllen aktuelle Marktanforderungen & Trends

Weitere Highlights der erweiterten Produktion sind die Verarbeitung unterschiedlicher Wafer mit bis zu 300 mm Durchmesser und das Bestücken auf Substraten mit einer maximalen Fläche von 600 x 550 mm². Mit einer Platziergenauigkeit von +/- 2,5µm @ 3sigma können Module zur optischen Datenübertragung ebenso wie Sensoren und Kameramodule produziert werden. Zusätzlich ist die Anbindung an ein voll automatisches Handling-System für Substrate bei hohen Stückzahlen obligatorisch und wird bei AEMtec ebenfalls realisiert.

Sensoren in hohen Produktionsvolumen zu attraktiven Preisen

Bereits seit 2008 ist AEMtec in diesem Segment aktiv und verfügt über umfangreiche Kompetenz und Fertigungsmöglichkeiten bei der hochgenauen Bestückung. Mit der jetzigen Produktionserweiterung in Berlin ist AEMtec in der Lage, auch für hohe Produktionsmengen nicht nur kurze Durchlaufzeiten, sondern zugleich auch attraktive Preise anbieten zu können.

Sie finden exceet / AEMtec vom 26. - 28. April 2016 auf der SMT Hybrid Packaging in Nürnberg in Halle 7A / Stand 331A

AEMtec präsentiert sich auf dem Fraunhofer IZM Gemeinschaftsstand mit dem Motto "Optics meets Electronics". Auf dem Forum in Halle 7A hält Matthias Lorenz einen Vortrag über hochgenaues Bestücken und worauf es dabei ankommt

Ihr AEMtec Direktkontakt:

Matthias Lorenz – Email: matthias.lorenz@aemtec.com - Tel. +49 160 90747793

Bildmaterial auf Anfrage verfügbar

Über exceet Group

exceet ist eine internationale Technologiegruppe, die sich auf die Entwicklung und Fertigung intelligenter, komplexer und sicherer Elektronik spezialisiert hat.

Über AEMtec GmbH

AEMtec, mit Firmensitz und Fertigungsstätte am renommierten Wissenschafts- und Technologiestandort Berlin Adlershof, entwickelt und fertigt hoch qualitative, kundenspezifische mikro- und optoelektronische Module. Das Unternehmen verfügt über modernste Packaging-Technologien, wie Chip on Board, Flip Chip, 3D-Integration und Opto-Packaging. Umfangreiche Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Machbarkeitsstudien zur Aufbau- und Verbindungstechnik, Design und Layout sowie Testequipment-Erstellung bis hin zur Serienproduktion runden das Dienstleistungsspektrum ab.

Kontakt

exceet Group AG
Riedstrasse 1
CH-6343 Rotkreuz

Judith Balfanz, Editorial Director
Tel. +49 211 – 43 69 890
judith.balfanz@exceet.ch / www.exceet.ch